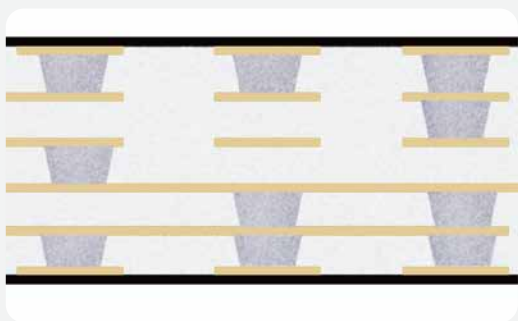


# 메탈라이즈 페이스트

반도체 용도 등, 높은 접속 신뢰성이 요구되는 기판에 최적!

## 용도

### 층간 접속 용도



고속 통신 기판에서의 층간 접속 이미지

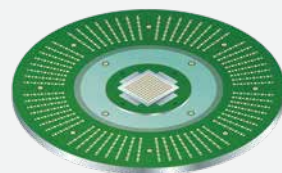
#### 민생품

이미지: 스마트폰 등의 고속 통신 기판



#### 반도체 검사기판

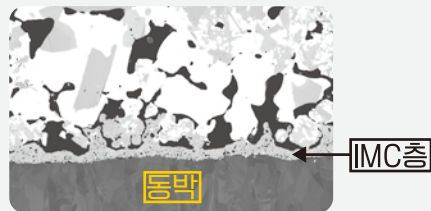
이미지: 프로브카드



## 특징

### 메탈라이즈 페이스트란

고융점, 저융점 금속 분말을 혼합한 금속 용융형 페이스트.  
가열 프레스함으로써 고융점과 저융점 금속이 IMC 층을 형성.  
동박과 IMC층을 형성하여 높은 접속신뢰성을 창출합니다.



- 동박과 IMC층 형성. 각종 기재에서 안정된 접속 신뢰성 실현.
- 고내열 · 고열전도성
- 스루홀 도금이 필요 없어 파인 패턴 형성이 용이함

## 라인업 & 특성

제품 품번			MP8300	MPA500	MPA510	MPA550
점도	BH형	dPa·s	1,400 ~ 2,200	1,000 ~ 2,000	900 ~ 1,700	1,200 ~ 2,000
경화조건	본경화		180°C×60분			
체적저항률[대표치]		Ω·cm	8.00E-05	1.50E-04	2.00E-04	8.00E-05
열전도성 (레이저 플래시법)		W/m·k	25	12		20
유리전이온도 (DMA)		°C	151	147		

